



## RE900

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para 14 SMD TSOP I y 7 diferentes SMD TSOP II chips
- Distancia entre las zonas terminales 0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil); 0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Puntos de ruptura controlada prerrayados para separar módulo individuales de la placa de circuito impreso
- Bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la impresión de pasta de soldar
- Tamaño 72,60 x 76,20 mm

| Módulo-No. | Typ     | Pitch    | Pin                | Tamaño (mm)   |
|------------|---------|----------|--------------------|---------------|
| RE900-01   | TSOP I  | 0,400 mm | 28, 40, 48, 60     | 12,00 x 18,00 |
| RE900-02   | TSOP I  | 0,500 mm | 28, 32, 40, 48     | 12,00 x 20,00 |
| RE900-03   | TSOP I  | 0,500 mm | 20, 24             | 6,00 x 16,00  |
| RE900-04   | TSOP I  | 0,650 mm | 16, 24, 28, 36     | 12,00 x 14,00 |
| RE900-05   | TSOP II | 0,800 mm | 40, 44             | 11,50 x 18,80 |
| RE900-06   | TSOP II | 1,270 mm | 20, 24, 26, 28, 32 | 11,50 x 21,30 |